高温アニール AIN 上 AIGaN 成長における超格子構造導入による歪み緩和

Strain Relaxation in AlGaN Grown on Annealed Sputtered AlN by Introduction of Superlattices 三重大 院工¹, 地創戦略企², 院地域イノベ³

O稲森 崇文¹, 石原 頌也¹, 白土 達也¹, 窪谷 茂幸², 正直 花奈子¹, 上杉 謙次郎², 三宅 秀人^{1,3} Grad. Sch. of Eng.¹, SPORR², Grad. Sch. of RIS³, Mie Univ.

^oTakafumi Inamori¹, Shoya Ishihara¹, Tatsuya Shirato¹, Shigeyuki Kuboya²,

Kanako Shojiki¹, Kenjiro Uesugi², Hideto Miyake^{1,3}

E-mail: kuboya.shigeyuki@mie-u.ac.jp

高効率な AlGaN 系発光デバイスの実現には、低コストで高品質な AlGaN 下地層が必要である。これまでに我々は、サファイア基板上にスパッタ法で AlN を堆積させた後、高温アニール処理を行うことで高い結晶性を有する AlN テンプレート(FFA Sp-AlN)を作製できることを報告した^[1]。しかし、サファイアと AlN の熱膨張係数差により FFA Sp-AlN は膜中に強い圧縮歪みを持つことが明らかになっている^[2]。そのため、FFA Sp-AlN テンプレート上に AlGaN 層を成長させると強い圧縮歪みを引き継ぎ、基板の反り増大や量子井戸構造での歪み緩和を引き起こすと考えられる。本研究では、FFA Sp-AlN テンプレート上に歪み緩和した AlGaN 層を成長させることを目的として、同テンプレートと AlGaN 層の間に AlN/GaN 超格子(SLs)構造を挿入し、歪み緩和の効果を検討した。

スパッタ法を用いてサファイア基板上に AIN を 450 nm 堆積し、1700°C で 3 時間アニールを行った。 これをテンプレートとし、MOVPE 法を用いて成長温度 1200°C で AIN 層を 200 nm 成長させた後、1080°C において 2 種類のキャリアガスを用いて AIN/GaN SLs 構造を 20 周期成長させた。次に、1150°C に昇温後、 AI 組成 70%の Si 添加 AlGaN (n-AlGaN)層を 1 µm 成長させた。キャリアガスとして、AIN 層と n-AlGaN 層 の成長には H₂を用い、AIN/GaN SLs 構造の成長には H₂ または N₂混合率 85%の H₂+N₂混合キャリアガス を用いた。Fig. 1 に n-AlGaN 表面の原子間力顕微鏡(AFM)像を示す。Fig. 1(a)より H₂キャリア試料では、ヒ ロックで覆われた表面であることがわかった。また、Fig. 1(b)より H₂+N₂ キャリア試料では、平坦性が改 善していることがわかった。Fig. 2 に SLs 構造を各キャリアガスで成長させた試料の(1015)X 線回折逆格子 空間マッピング(XRD-RSM)を示す。両試料ともに SLs 構造において緩和し、n-AlGaN 層は SLs 層にコヒー レントに成長していることがわかった。AIN 層に対する n-AlGaN 層の緩和率を求めると、それぞれ 100% および 91% であった。n-AlGaN の(0002)および(1012)X 線ロッキングカーブ半値全幅は H₂キャリア試料で それぞれ 199 および 467 arcsec、H₂+N₂キャリア試料でそれぞれ 139 および 355 arcsec であり、H₂+N₂キャ リアで SLs 構造を成長させた試料の方が高品質な n-AlGaN 膜が得られた。これは、SLs 構造成長時に N₂ キャリアを用いた場合、H₂キャリアに比べて過飽和度が増加することで高密度の島が形成され、n-AlGaN 成長でそれらを埋め込む成長が生じたことが示唆される。



SLs grown with (a) H₂ and (b) H₂+N₂ carrier gases.

Fig. 2. XRD-RSMs of n-AlGaN (1015) on SLs grown with (a) H₂ and (b) H₂+N₂ carrier gases.

 [1] H. Miyake et al., J. Cryst. Growth 456, 155 (2016).
[2] S. Tanaka et al., J. Cryst. Growth 512, 16 (2019).
【謝辞】本研究の一部は、文部科学省「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」、「省エネルギー社会の実現に資 する次世代半導体研究開発」、JSPS 科研費(16H06415, 19K15025)、JST CREST(16815710)の支援により行われた。